

成都高新区电子信息产业局

成高电发〔2024〕3号

签发人：杨刚

成都高新区电子信息产业局 关于印发《〈成都高新技术产业开发区关于支持集成电路产业高质量发展的若干政策〉实施细则（试行）》的通知

各街道办事处、各部门、各直属单位：

根据《成都高新区管委会印发〈成都高新技术产业开发区关于支持集成电路产业高质量发展的若干政策〉的通知》（成高管发〔2024〕13号）精神，现将《〈成都高新技术产业开发区关于支持集成电路产业高质量发展的若干政策〉实施细则（试行）》印发你们，请遵照执行。

(此页无正文)

成都高新区电子信息产业局

2024年10月8日



《成都高新技术产业开发区 关于支持集成电路产业高质量发展的若干 政策》实施细则（试行）

为贯彻落实《成都高新技术产业开发区关于支持集成电路产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》），进一步细化政策内容，理顺操作规程，特制订本实施细则。

一、支持范围

本实施细则适用于登记注册、税收关系在成都高新区，具有独立法人资格，从事集成电路设计、制造、封测、设备（零部件）、材料的研发制造应用、专业园区管理服务业务的企事业单位及机构（行业协会、民非组织），以及符合条件的成都市内高校、科研院所。其中，第五、六、七、十四条的适用范围拓宽至登记注册、税收关系在成都市其他区（市）县与成都高新区合作共建的园区（以下简称合作园区）内，从事集成电路设备（零部件）、材料研发制造，服务于成都高新区链主企业的配套企业。企业管理规范，无不良信用记录，自觉遵守安全生产、环境保护等方面的法律法规，近三年未发生重大安全事故。

二、支持原则

本实施细则实行预算管理和总量控制，认定的金额不含增值税（进项税），为防止财政奖补资金碎片化，补贴金额

按去尾法保留至万位，认定补助（奖励）资金低于 1 万元的项目，不纳入支持范围。同类文件标准不一致的，按照“取高不重复”的原则执行。已享受“一企一策”相关政策的企业不再重复享受本政策类似条款。本政策与成都市集成电路政策类似条款（MPW 流片、全掩膜首轮工程产品流片），经审核认定，超出市级支持的部分由成都高新区给予支持。

三、申报时间

原则上每年集中申报一次，具体申报时间以成都高新区官网或“高新通”亲清在线平台（<https://www.cdhtqyfw.cn/>）发布的申报通知为准。

四、申报方式

本细则条款分为“免申即享”“易申快享”2 种类型。“免申即享”条款无需企业申报，由相关部门按照政策支持对象、支持标准、采信渠道等规定，确定奖补企业名单后直接拨付奖补资金，相关流程按《成都高新区政策“免申即享”工作机制（试行）》执行。“易申快享”条款需企业在“高新通”进行线上申报，由成都高新区相关部门审批通过后拨付奖补资金，相关流程按《成都高新区产业发展专项资金管理办法》（成高管发〔2023〕8号）执行。

“易申快享”条款的申报材料包括通行材料和附加材料两部分，附加材料按照本实施细则中第五条“申报规程”中对《若干政策》各条款的具体规定执行。通行材料如下：

1. 《成都高新区集成电路政策资金申报表》；
2. 具有统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书和法定代表人身份证复印件；
3. 企业前两年及当年完税证明（按入库期打印）或无欠税证明（加盖税务部门鲜章或电子章）；
4. 企业申报材料真实性及不重复申报承诺书，涉及采购销售合同的，还需提交双方无关联关系承诺书（法定代表人签字（章））；
5. 由会计师事务所出具的申报单位上一年度审计报告（带二维码）。
6. 如申报材料覆盖时期内发生过企业更名的，需提供准予名称变更等工商底档材料；

五、申报规程

（一）集成电路设计政策。

第一条 支持企业加大研发投入。

支持方向一：对 IC（集成电路）设计企业通过国家级公共服务平台租用 EDA（电子设计自动化）工具，按照租赁费用的 50% 给予最高 100 万元补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

通过成都市集成电路设计企业评估的设计企业，上一年度通过国家级公共服务平台租用 EDA 工具或 EDA 云服务进行芯片研发，并流片验证的。

2. 支持标准。

按租赁费用的 50% 给予企业每年最高 100 万元补贴。

3. 附加材料。

(1) EDA 的租用合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件；

(2) 采用 EDA 研发产品情况介绍（需详细说明研发产品的型号、名称、功能、作用，采用的流片工艺、线宽，产品应用领域、销售情况等信息）；

(3) 采用 EDA 所研发产品的流片业务统计表、流片合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件；通过第三方服务平台或技术服务流片，还需提供 WIP 信息和出货清单（加盖申报企业和服务平台或技术服务商鲜章）；对于尚未进行流片的企业，需提供流片计划的书面说明；

(4) 如已流片，需提供能证明流片产品是企业自营产品的佐证资料，如出入库信息、销售证明等；

(5) 芯片版图缩略图；

(6) 通过成都市集成电路设计企业评估的证明材料。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向二：对设计企业使用多项目晶圆（MPW）进行集成电路产品研发流片的，按照流片费用的 70% 给予最高 500

万元补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

通过成都市集成电路设计企业评估或与成都高新区签署的投资合作协议中明确支持其享受流片补贴条款的设计企业，上一年已使用多项目晶圆（MPW）进行研发流片，并承诺在成都高新区开展该产品产业化工作。

2. 支持标准。

按照流片费用 70% 给予每年最高 500 万元补贴。

3. 附加材料。

（1）申报项目的流片加工业务统计表，流片合同或订单、发票及银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）；通过第三方服务平台或技术服务流片，还需提供情况说明以及 WIP 信息、出货清单（加盖申报企业和服务平台或代理机构（中介）鲜章）或其他相关佐证材料；

（2）提供能证明流片产品是企业自营产品，且在成都高新区销售结算的佐证资料，如出入库信息、销售证明等；如暂未销售，提供在成都高新区销售结算的承诺书；

（3）申报流片产品情况介绍，需详细说明研发产品的型号、名称、功能、作用，采用的流片工艺、线宽，产品应用领域、销售情况等信息；

（4）芯片版图缩略图；

（5）正版软件使用证明复印件；

(6) 通过成都市集成电路设计企业评估的证明材料或与成都高新区签署的投资合作协议复印件。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向三：对 IC 设计企业开展处理器芯片、通信芯片、感知芯片、功率半导体、存储器芯片、显示驱动芯片等全掩膜（Full Mask）首轮工程产品流片的，按照流片费用的 50% 给予最高 3000 万元补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

通过成都市集成电路设计企业评估或与成都高新区签署的投资合作协议中明确支持其享受流片补贴条款的设计企业，上一年已完成处理器芯片（CPU、GPU、DSP、AI 芯片、SOC、FPGA、MCU）、通信芯片（射频、基带、信号链、光电子）、感知芯片（传感器及相应信号处理、传输芯片）、功率半导体、存储器芯片、显示驱动芯片等全掩膜首轮工程产品流片，并承诺在成都高新区开展该产品产业化工作。

2. 支持标准。

按照流片费用的 50% 给予企业每年最高 3000 万元补贴，流片费用包括首轮工程批光罩费和同次晶圆费用（单个产品晶圆不超过 25 片）。

3. 附加材料。

(1)申报项目的流片加工业务统计表,流片合同或订单、发票及银行划款凭证等相关材料复印件(加盖申报企业鲜章);通过第三方服务平台或技术服务流片,还需提供情况说明以及WIP信息、出货清单(加盖申报企业和服务平台或技术服务商鲜章)等相关佐证材料;

(2)提供能证明流片产品是企业自营产品,且在成都高新区销售结算的佐证资料,如出入库信息、销售证明等;如暂未销售,提供在成都高新区销售结算的承诺书;

(3)申报流片产品情况介绍,需详细说明研发产品的型号、型号与光罩对应关系、名称、功能、作用,采用的流片工艺、线宽,产品应用领域、销售情况等信息;

(4)芯片版图缩略图。

(5)正版软件使用证明复印件。

(6)通过成都市集成电路设计企业评估的证明材料与高新区签署的投资合作协议复印件。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

第二条 支持企业加强生态合作。

支持方向一:对IC设计企业围绕产业生态合作,与晶圆代工厂首次签署流片合作协议(一年及以上),且流片量不低于12000片/年、24000片/年的,分别给予500万元、800

万元奖励。（易申快享）

1. 申报条件。

IC 设计企业，围绕区域产业生态合作，与晶圆代工厂首次签署一年以上流片合作协议。

2. 支持标准。

对企业流片量不低于 12000 片/年、24000 片/年的，分别给予 500 万元、800 万元的奖励，按照企业签订流片合作协议、首次 NTO、第一个完整量产年流片量达标三个阶段，分别兑现奖励总金额的 20%，30%，50%。第一个完整量产年流片量，指从 NTO 验证完成后的首张量产订单开始计算，满一年为止的流片量。核算企业年流片量，不限于单款产品。若未达到协议流片量的 50%，原则上需退回已享受的奖励资金。

3. 附加材料。

（1）与晶圆代工厂的流片合作协议（协议中需明确约定年流片量）；

（2）上一年流片情况介绍，需详细说明流片产品的型号、型号与光罩对应关系、名称、功能、作用，采用的流片工艺、线宽，产品应用领域、销售情况等信息（加盖申报企业鲜章）；

（3）流片加工业务统计表（加盖晶圆代工厂鲜章，对首次 NTO、首次量产信息进行标注）、申报项目的首次 NTO 订单（申报第二笔资金提供）、量产流片订单（申报第三笔资金提供，并对首次量产流片订单特别标注）、发票及银行划

款凭证等相关材料复印件；

(4) 芯片版图缩略图；

(5) 正版软件使用证明复印件。

(6) 通过代理或技术服务流片的，提供情况说明及相关佐证材料。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向二：对 IC 设计企业围绕产业生态合作，向晶圆代工厂导入产品，且企业流片量不低于 6000 片/年的，按照新产品流片（NTO）费用（含光罩及不超过 200 片晶圆）的 70% 给予最高 3000 万元补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

IC 设计企业围绕区域产业生态合作，向晶圆代工厂导入成熟产品，且流片量不低于 6000 片/年（从 NTO 验证完成后的首张量产订单开始计算，满一年为止的流片量）的集成电路设计企业。首次 NTO 至完成 6000 片/年流片时间不超过 24 个月。

2. 支持标准。

流片量未达到 6000 片/年时，按照第一条支持方向三的标准给予支持；流片量达到 6000 片/年后，按照 NTO 费用（含光罩及不超过 200 片晶圆）的 70%，每年最高 3000 万元，核

算后给予补差。核算企业年流片量，不限于单款产品。

3. 附加材料。

(1) 年流片量是否达到 6000 片/年的说明，附流片加工业务统计表（加盖晶圆代工厂鲜章）；

(2) 申报项目的流片合同或订单、发票及银行划款凭证等相关材料复印件；通过第三方服务平台或技术服务流片，还需提供情况说明以及 WIP 信息、出货清单（加盖申报企业和服务平台或技术服务商鲜章）等相关佐证材料；

(3) 流片情况介绍，需详细说明流片产品的型号、型号与光罩对应关系、名称、功能、作用，采用的流片工艺、线宽，产品应用领域、销售情况等信息（加盖申报企业鲜章）；

(4) 提供能证明导入流片产品是成熟产品的佐证资料，不限于该产品在其他晶圆厂量产订单；

(5) 芯片版图缩略图；

(6) 正版软件使用证明复印件；

(7) 通过代理或技术服务流片的，提供情况说明及相关佐证材料。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向三：对 IC 设计企业围绕产业生态合作，在晶圆代工厂进行生产流片（不含工程批）的，按照流片费用的 5%

给予每年最高 500 万元补贴。对年出货晶圆数量大于 6 万片的，按“一事一议”原则给予支持。（易申快享）

1. 申报条件。

IC 设计企业围绕产业生态合作，在晶圆代工厂进行生产流片。

2. 支持标准。

按照流片费用的 5% 给予每年最高 500 万元补贴。

3. 附加材料。

（1）上一年生产流片情况介绍，需详细说明流片产品的型号、型号与光罩对应关系、名称、功能、作用，采用的流片工艺、线宽，产品应用领域、销售情况等信息（加盖申报企业鲜章）；

（2）流片加工业务统计表（加盖晶圆代工厂鲜章）、申报的流片合同或订单、发票及银行划款凭证等相关材料复印件。通过第三方服务平台或技术服务流片，还需提供情况说明以及 WIP 信息、出货清单（加盖申报企业和服务平台或技术服务商鲜章）等相关佐证材料；

（3）芯片版图缩略图；

（4）正版软件使用证明复印件；

（5）通过代理或技术服务流片的，提供情况说明及相关佐证材料。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向四：对 IC 设计企业与封装、测试厂及平台合作开展封装测试的，按照封测费用较上一年度费用增量的 15% 给予最高 100 万元补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

通过成都市集成电路设计企业评估，围绕区域产业生态合作，与封装、测试厂及平台合作开展封装测试的设计企业。

2. 支持标准。

按照区域合作封装、测试费用较上一年费用增量的 15% 给予最高 100 万元补贴。

3. 附加材料。

（1）封装测试加工业务统计表，封装测试合同或订单、发票及银行划款凭证等相关材料复印件。通过第三方服务平台或代理机构委托封测的，企业还需提供出货清单（加盖申报企业和服务平台或代理机构鲜章）；

（2）提供能证明封装测试产品是企业自营产品的佐证资料，如出入库信息、销售证明等；

（3）申报封测产品情况介绍，需详细说明封测产品的型号、名称、功能，采用的封测工艺，产品应用领域、销售情况等信息；

（4）芯片封装图纸；

(5) 正版软件使用证明复印件；

(6) 由会计师事务所出具的专项审计报告（需反映两年区域所有合作单位封测服务费具体金额及较上一年度增加额）；

(7) 通过成都市集成电路设计企业评估的证明材料。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

(二) 晶圆制造、封装测试政策。

第三条 支持企业加大项目投入。（易申快享）

对新引进的集成电路晶圆制造、封测项目以及企业新建或实施技术升级改造的产线，且上一年固定资产投资超 1000 万元的，按照上一年固定资产实际投资额的 8% 给予最高 2000 万元补贴，单个项目最高不超过 4000 万元。对特别重大的项目，按“一事一议”原则给予支持。

1. 申报条件。

(1) 新引进且上一年固定资产投资超 1000 万元的晶圆制造或封装、测试项目企业；

(2) 集成电路存量企业新建晶圆制造或封装、测试产线，或对已有产线实施技术升级，且上一年固定资产投资超 1000 万元的；

(3) 第(1)(2)条满足其一即可。新引进指自 2023

年 1 月 1 日之后注册登记。企业新建或实施技术升级改造的项目需在 2023 年 1 月 1 日后登记备案。

2. 支持标准。

按照上一年度固定资产实际投资额的 8% 给予最高 2000 万元补贴，单个项目补贴额最高不超过 4000 万元。

3. 附加材料。

(1) 申报项目情况介绍，需详细说明项目名称、总投资、建设内容、建设计划、项目建成后预期效益（经济、社会）、截至上一年度累计完成投资情况等信息；

(2) 项目备案文件、项目投资入库证明材料等；

(3) 上一年度固定资产投资发票明细汇总表、项目固定资产投资相关合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件；

(4) 由会计师事务所出具的申报项目上一年固定资产投资专项审计报告。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业处。

第四条 支持企业提升制造、封测服务能力。

支持方向一：鼓励晶圆制造企业开放产能，为行业企业提供代工流片服务，按照代工费用的 5% 给予最高 1 亿元补贴。

(易申快享)

1. 申报条件。

为行业企业提供代工流片服务，且完成出货的晶圆制造企业。

2. 支持标准。

按照为行业企业代工流片费用的 5% 给予最高 1 亿元补贴。

3. 附加材料。

(1) 服务行业企业流片业务统计表（含服务企业组织机构代码信息，加盖申报企业鲜章）；

(2) 由第三方会计师事务所出具的服务行业企业代工流片业务专项审计报告（反映服务企业名称及费用情况）。（审核时现场核查流片合同或订单、发票及银行划款凭证、出货凭证等材料原件）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

支持方向二：对已量产的封测企业为行业企业提供先进封装及高可靠性封装测试服务的，按照封装测试费用增量的 5% 给予最高 500 万元补贴；对新投产的先进封装及高可靠性封装企业，按照封装测试费用增量的 10% 给予最高 500 万元补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

(1) 为设计企业提供先进封装及高可靠性封装测试服务且完成出货的封装测试企业；

(2) 新投产指 2023 年 1 月 1 日之后投产，截至上一年度，企业投产未满 3 年（投产 3 年后，默认为已实现量产）。先进封装包括晶圆级封装、FO 封装、系统级封装、倒装芯片、BGA/CSP、2.5D/3D 堆叠封装等。

2. 支持标准。

(1) 对已量产的封测企业为行业企业提供先进封装及高可靠性封装测试服务的，按照封装测试费用增量的 5% 给予最高 500 万元补贴；

(2) 对新投产的先进封装及高可靠性封装企业，按照服务订单费用增量的 10% 给予最高 500 万元补贴。

3. 附加材料。

(1) 服务企业封测业务统计表，需包括服务企业名称、封测产品型号、采用封装技术、当年及上一年服务金额等信息；

(2) 封装和测试业务合同或订单、发票及银行划款凭证、出货凭证等相关材料复印件；

(3) 由会计师事务所出具的专项审计报告（带二维码，需反映两年合作单位先进封装及高可靠性封装测试服务费具体金额及较上一年度增加额）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处

（三）设备（零部件）、材料政策。

第五条 加快上下游供应链项目落地。（易申快享）

对成都高新区新备案以及成都高新区协同引进、落地合作园区的设备（零部件）、材料等配套企业，且上一年固定资产投资超 500 万元的，按照上一年固定资产投资额不超过 10% 给予最高 1000 万元补贴，单个项目最高不超过 2000 万元。对特别重大的项目，按照“一事一议”原则给予支持。

1. 申报条件。

（1）成都高新区新备案设备（零部件）、材料配套项目的企业，上一年固定资产投资超 500 万元；

（2）成都高新区协同引进，落地合作园区的设备（零部件）、材料配套项目企业，上一年固定资产投资超 500 万元；

（3）第（1）（2）条满足其一即可。新备案指自 2023 年 1 月 1 日之后登记备案。协同引进，落地合作园区的设备（零部件）、材料配套项目指高新区参与新项目协议签订，且 2023 年 1 月 1 日之后登记备案。

2. 支持标准。

（1）注册登记在成都高新区的企业按照申报上一年固定资产实际投资额的 10% 给予最高 1000 万元补贴，单个项目补贴额最高不超过 2000 万元；

（2）注册登记在合作园区的企业按照上一年固定资产实际投资额的 5% 给予最高 500 万元补贴，单个项目补贴额最高

不超过 1000 万元。

3. 附加材料。

(1) 申报项目情况介绍，需详细说明项目名称、总投资、建设内容、建设计划、项目建成后预期效益（经济、社会）、截至上一年度累计完成投资情况等信息；

(2) 项目备案文件、项目投资入库证明材料等；

(3) 上一年度固定资产投资发票明细汇总表、项目固定资产投资相关合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件；

(4) 由会计师事务所出具的申报项目上一年固定资产投资专项审计报告；

(5) 高新区晶圆制造链主企业出具的双方配套合作关系证明（合作园区内企业提供）；

(6) 其他证明业务真实性的补充材料。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业处。

第六条 支持设备、材料验证应用。

支持方向一：鼓励集成电路晶圆制造、封测链主企业开展自主安全可控设备（零部件）、材料验证应用，按照通过验证并应用的设备、零部件、材料产品，分别给予每款 20 万元、10 万元、10 万元的一次性奖励。（易申快享）

1. 申报条件。

(1) 区内集成电路晶圆制造、封测链主企业对国内企业自主研发、生产的设备（零部件）、材料开展验证应用的；

(2) 注册登记在成都高新区或合作园区的集成电路设备（零部件）、材料企业，产品进入国内外知名企业进行验证的；

(3) 第(1)(2)条满足其一即可。

2. 支持标准。

(1) 对集成电路晶圆制造、封测链主企业开展设备（零部件）、材料验证并应用的，按照设备、零部件、材料产品，分别给予每款 20 万元、10 万元、10 万元的一次性奖励，单个企业每年最高不超过 500 万元。

(2) 对集成电路设备（零部件）、材料企业产品进入国内外知名企业进行验证的，按照进场验证费用的 20%，给予企业每年最高 200 万元补贴；注册登记在合作园区的企业按照以上标准的 50% 予以支持，即按照进场验证费用的 10%，给予企业每年最高 100 万元补贴。

(3) 国内外知名企业是指集成电路晶圆制造、封装测试领域上一年度营收规模排名全球前 20 或中国前 10 的企业。

3. 附加材料。

晶圆制造、封测链主企业提供：(1) 已验证应用产品汇总清单，并详细说明产品名称（型号）、国产供应商、功能、主要技术指标、验证及应用情况等信息；(2) 已验证应用产

品属于国内企业自主研发、生产的设备（零部件）、材料的说明，以及相应验证报告、采购合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件。

设备（零部件）、材料企业提供：（1）已在国内外知名企业验证产品汇总清单，并详细说明产品名称（型号）、功能、主要技术指标、协助验证企业名称、验证及应用情况等信息；（2）合作验证企业是国内外知名企业的佐证材料，合作园区内企业补充提供由高新区晶圆制造链主企业出具的双方配套合作关系证明；（3）已验证产品的验证报告、进场验证费用说明、验证费用相关的合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

支持方向二：企业成功研制集成电路装备首台（套）（新材料首批次）并实现销售的，按照产品首次进入市场实际销售金额不超过 30% 给予最高 3000 万元奖励。（易申快享）

1. 申报条件。

（1）注册登记在成都高新区或合作园区，集成电路相关产品具有自主知识产权，且自 2023 年 1 月 1 日后获得省级以上重大技术装备首台（套）、新材料首批次认定，并实现销售的企业；

(2) 集成电路装备，包括单机装备、成套装备和核心部件；

(3) 省级以上首台（套）重大技术装备、首批次新材料的认定以四川省经济和信息化厅（<https://jxt.sc.gov.cn/>）发布的名单为采信依据。

2. 支持标准。

(1) 对认定为国内首台（套）首批次的产品，按首次进入市场合同的金额的 30%比例给予不超过 3000 万元奖励；

(2) 对认定为省内首台（套）首批次的产品，按首次进入市场合同的金额的 20%比例给予不超过 1000 万元奖励；

(3) 首次进入市场实际销售额指产品实现销售的前 3 个合同实际销售额，且合同之间的时间跨度不超过半年；

(4) 注册登记在合作园区的企业，按照以上标准的 50%予以支持，既认定为国内首台（套）首批次的产品，按首次进入市场合同的金额的 15%比例给予不超过 1500 万元奖励；认定为省内首台（套）首批次的产品，按首次进入市场合同的金额的 10%比例给予不超过 500 万元奖励。

3. 附加材料。

(1) 产品获得省级以上装备首台（套）、新材料首批次认定的证明材料；

(2) 产品首次进入市场实际销售情况说明，销售合同、发票、银行划款凭证、产品交付证明等相关材料复印件；

(3) 产品自上市至上一年度收入规模构成表(含合同编号、合同签订日期、采购方,数量、金额,发票信息等内容);合作园区内企业补充提供由高新区晶圆制造链主企业出具的双方配套合作关系证明。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

第七条 支持供应链协同。

支持方向一:对集成电路行业非关联企业之间首次形成设备(零部件)、材料、软件、循环清洗服务等供应链的,按照上年实际购销金额的10%给予最高500万元补贴(供需双方各5%);金额持续增长的,按照上年实际购销金额的5%给予最高500万元补贴(供需双方各2.5%),单个企业每年最高不超过1000万元,合作园区供方减半支持。(易申快享、免申即享)

1. 申报条件。

(1) 采购非关联企业设备(零部件)、材料、软件、循环清洗服务的集成电路制造、封测企业;

(2) 注册登记在成都高新区或合作园区,向条件(1)的企业销售自主研发生产的设备(零部件)、材料(不含大宗气体)、软件、循环清洗服务的企业;

(3) 第(1)(2)条满足其一即可。

2. 支持标准。

(1) 首次形成设备（零部件）、材料（不含大宗气体）、软件、循环清洗服务等有效供应链的，用户单位和生产单位均可按第一年购销合同实际执行金额的 5%，申请享受最高 250 万元的奖励；获得首次补助后，该供应链配套能力持续增强，购销合同实际执行金额同比上一年度增长 20% 以上的，用户单位和生产单位均可按上一年度购销合同实际执行金额的 2.5%，申请享受最高 250 万元的奖励；单个企业每年支持金额不超过 1000 万元；

(2) 注册登记在合作园区的企业按照以上标准的 50% 予以支持，即首次形成设备（零部件）、材料（不含大宗气体）、循环清洗服务等有效供应链的，对生产单位可按第一年购销合同实际执行金额的 2.5%，给予最高 125 万元的奖励；获得首次补助后，该供应链配套能力持续增强，购销合同实际执行金额同比上一年度增长 20% 以上的，按上一年度购销合同实际执行金额的 1.25%，给予最高 125 万元的奖励；单个企业每年支持金额不超过 500 万元。

(3) 政策由需求方统一申请，审核确定供需双方支持金额后，采信需求方的材料，对供应方按“免申即享”拨付支持资金。

3. 附加材料。

(1) 近三年采购产品汇总清单，需详细说明供应商、产

品名称（型号）、数量、实际购销费用、注明首次采购或持续采购等信息；

（2）购销合同、发票、银行划款凭证、产品接收或验收单等相关材料复印件；

（3）由第三方会计师事务所出具的公司申报的供应链购销金额专项审计报告（需按不同供应方分别统计采购金额）。

（4）申报首次采购的提供产品首次采购承诺书（供需双方盖章）。

（5）供应方协助提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件，加盖供应方鲜章。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

支持方向二：对新建晶圆制造、封测产线，采购国内国际核心原材料，按照产生物流费用的 90% 给予每年最高 3000 万元补贴；采购其他关键原材料、零部件，按照产生物流费用不超过 30% 给予每年最高 1000 万元补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

（1）2023 年 1 月 1 日起新注册成立公司，新开工建设晶圆制造、封测产线，且从省外采购关键原材料、零部件的企业；

（2）核心、关键原材料、零部件指集成电路工艺材料（包

括光刻类化学品、研磨液、电子特种气体、特种化学品、靶材）、硅片及装备核心部件（不包括单机装备和成套装备）。

2. 支持标准。

（1）对采购国内国际核心原材料，按照相对长三角地区增加物流费用的 90%，给予每年最高 3000 万元补贴；

（2）对采购其他关键原材料、零部件，从开工建设起，分别按照第一、二、三年产生的相对长三角地区增加物流费用的 30%、20%、10%，给予最高每年 1000 万元补贴。

3. 附加材料。

（1）上一年度自省外采购核心原材料以及关键原材料、零部件物流费用汇总清单，包括供应商、产品名称（型号）、数量、起运地、承运商、合同编号（或订单号）、相对长三角地区增加物流费用等信息。

（2）采购原材料、零部件的合同（或订单与报价单）、发票及银行划款凭证等相关材料复印件，对应同类产品在三长三角地区采购的合同（或订单与报价单）、发票等相关材料复印件，或者其他能证明相对长三角地区增加物流费用的材料。

（3）由第三方会计师事务所出具的公司申报的物流增加费用专项审计报告。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

（四）产业生态跃升政策。

第八条 加快培育龙头企业及行业隐形冠军。

支持方向一：对 IC 设计企业年度主营业务收入首次突破 2000 万元、1 亿元、5 亿元、10 亿元、20 亿元的；对晶圆制造、封装测试企业年度主营业务收入首次突破 1 亿元、5 亿元、10 亿元、20 亿元、100 亿元的；对设备（零部件）、材料企业年度主营业务收入首次突破 2000 万元、1 亿元、3 亿元、5 亿元、10 亿元的，按照晋档补差原则分别给予核心团队 100 万元、300 万元、500 万元、800 万元、1000 万元一次性奖励。（易申快享）

1. 申报条件。

（1）上一年度主营业务收入首次突破 2000 万元、1 亿元、5 亿元、10 亿元、20 亿元的集成电路设计企业；

（2）上一年度主营业务收入首次突破 1 亿元、5 亿元、10 亿元、20 亿元、100 亿元的晶圆制造、封装测试企业；

（3）上一年度主营业务收入首次突破 2000 万元、1 亿元、3 亿元、5 亿元、10 亿元的集成电路设备（零部件）、材料企业；

（4）申报企业需上规入库，第（1）（2）（3）条满足其一，且只能享受其一，实施晋档补差；

（5）核心团队由企业自主决定，60%的成员需满足劳动合同、社保、个税均在成都公司，且主体一致；同一年

度该支持方向与成都市集成电路政策中类似条款不重复享受，奖励支持的核心团队成员不重复申报享受本政策第九条支持方向一（高级管理人才和研发人才奖励）；

（6）主营业务指集成电路设计、晶圆制造、封装测试、装备材料等业务。

2. 支持标准。

根据企业上一年度主营业务收入情况，按晋档补差原则，分别给予企业核心团队 100 万元、300 万元、500 万元、800 万元、1000 万元奖励。

3. 附加材料。

（1）申报企业核心团队名单及资金分配方案；

（2）申报企业核心团队成员个人身份证复印件、劳动合同（聘用合同）、社保证明（本人签字）、个人所得税完税证明；

（3）由会计师事务所出具的申报企业上台阶年度和上台阶上一年度审计报告（带二维码）；

（4）企业提供自成立以来首次达到相应条件的证明材料（由会计师事务所出具的专项审计报告或其他证明材料）；

（5）企业自成立以来历年缴税情况材料；

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业处。

支持方向二：对通过“国家鼓励的重点集成电路设计企业”备案的，给予 100 万元一次性奖励。（免申即享）

1. 支持对象。

通过“国家鼓励的重点集成电路设计企业”备案的企业。

2. 支持标准。

给予 100 万元一次性奖励。

3. 采信依据。

以国家发展改革委、工业和信息化部会同财政部、税务总局等相关部门发布的清单为依据（如机构调整，以新机构发布的名单为准）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向三：对首次获评国家级制造业单项冠军示范企业、产品的集成电路企业，分别给予 100 万元、50 万元一次性奖励；对复审通过的，分别给予 50 万元、30 万元一次性奖励。（免申即享）

1. 支持对象。

首次获评及复审通过国家级制造业单项冠军示范企业、产品的集成电路企业；

2. 支持标准。

（1）集成电路企业首次获评国家级制造业单项冠军示范

企业的，给予 100 万元一次性奖励；首次获评国家级制造业单项冠军产品的，给予 50 万元一次性奖励；

（2）集成电路企业复审通过国家级制造业单项冠军示范企业的，给予 50 万元一次性奖励；复审通过国家级制造业单项冠军产品的，给予 30 万元一次性奖励。

3. 采信依据。

以工业和信息化部（<https://www.miit.gov.cn/>）发布的名单为依据（如机构调整，以新机构发布的名单为准）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

支持方向四：对首次获评国家级专精特新“小巨人”、省级专精特新的集成电路企业，分别给予 50 万元、30 万元一次性奖励；对复审通过的，分别给予 30 万元、10 万元一次性奖励。（免申即享）

1. 支持对象。

首次获评或复审通过的国家级专精特新“小巨人”、省级专精特新的集成电路企业。

2. 支持标准。

（1）集成电路企业首次获评国家级专精特新“小巨人”、省级专精特新的，分别给予 50 万元、30 万元一次性奖励；

（2）集成电路企业复审通过国家级专精特新“小巨人”、

省级专精特新的，给予 30 万元、10 万元一次性奖励。

3. 采信依据。

以工业和信息化部（<https://www.miit.gov.cn/>）、四川省经济和信息化厅（<https://jxt.sc.gov.cn/>）发布的名单为依据（如机构调整，以新机构发布的名单为准）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

第九条 支持企业聘用培养关键人才。

支持方向一：对 IC 设计企业人力资源成本支出超过 50 万元以及制造、封测、设备（零部件）、材料企业人力资源成本支出超过 30 万元的高级管理人才和研发人才，按照人才使用效能，分梯度给予企业每人每年最高 50 万元，用于人才绩效奖励。（易申快享）

1. 申报条件。

（1）登记注册在成都高新区的 IC 设计（需通过成都市集成电路设计企业评估）、制造、封测、设备（零部件）、材料企业；

（2）IC 设计企业申请奖励人才的上一年人力资源成本支出超过 50 万，制造、封测、设备（零部件）、材料企业申请奖励人才的上一年人力资源成本支出超过 30 万元；

（3）企业申请奖励的人才需与企业签订三年及以上全职

劳动合同，申报时劳动关系仍然存续，且满足劳动合同、社保、个人所得税缴纳主体一致（高管社保可例外）；上一年度内，企业为申请奖励的人才连续缴纳社保及个人所得税不少于6个月（退休返聘、外籍或港澳台员工无需社保缴纳凭证）；

（4）企业申请奖励的人才需没有受到过刑事处罚，或者受到刑事处罚已经结束。

2. 支持标准。

（1）经认定，对企业人力资源成本支出超过30万元、50万元、80万元、150万元、300万元、500万元的人才，分别按照1万元/人、2万元/人、5万元/人、12万元/人、25万元/人、50万元/人的标准给予企业补贴，用于人才绩效奖励，鼓励发放给员工个人，每人最多申报3年；

（2）企业人力资源成本支出包括：企业支付给员工的薪酬（税前）、企业为员工缴纳的社保；

（3）人才使用效能指参考上一年度行业人均营业收入水平，确定企业支持人数。每年发布申报通知时明确标准。奖励主要支持研发技术人员，单个企业申请副总经理及以上级别的高级管理人才不超过5人。支持人数未上规的企业原则上不超过3人，规上企业原则上不超过企业上年社保人数的20%，重点企业支持人数最高可增加至社保人数的50%。

3. 附加材料。

(1) 人才奖励资金申报汇总表；

(2) 设计企业提供通过成都市集成电路设计企业评估的证明材料；

(3) 企业统一出具申报的人才未受到过刑事处罚或者刑事处罚已结束承诺书（企业盖章）；

(4) 企业为申报人才缴纳社会保险、医疗保险证明材料；

(5) 申报人才《年度支付综合所得收入和扣缴个人所得税情况表》；

(6) 申报人才学历证明、任职证明、劳动合同等相关材料复印件；

(7) 研发人才需提供参与项目、取得成果、获得荣誉等补充支撑材料。

备注：(1) — (4) 资料可以共用；如企业申报人数较多，按照(5) — (7) 的顺序准备完 A 人才的材料后，再按照(5) — (7) 的顺序准备 B 人才的材料，以此类推。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向二：对企业委托专业机构开展工程师技术能力提升培训的，按照企业实际支付培训费用的 20% 给予最高 50 万元的培训补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

(1) 委托专业培训机构开展集成电路类工程师技术能力提升培训的企业；

(2) 培训项目为集成电路类工程师技术能力提升培训，培训课程时长不少于 24 课时，每个课时不少于 45 分钟；

(3) 当企业安排同一职工参加多个培训项目时，上一个培训项目结束后才能参加下一个培训项目，同一职工同一培训项目不得重复享受补贴。

(4) 以上 (1) (2) (3) 条需同时满足。

2. 支持标准。

按照企业实际支付培训费用的 20% 给予每年最高 50 万元的培训补贴。

3. 附加材料。

(1) 委托培训机构培训资质证明、委托培训协议、培训人员名单，培训费用发票及银行划款凭证；

(2) 培训证明材料（包括但不限于：培训记录、课程安排、培训照片、培训结果验收材料等）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

第十条 支持高水平创新平台建设及技术攻关。

支持方向一：对新获批的集成电路领域省级制造业创新中心、产业创新中心、技术创新中心，给予最高 1000 万元一

次性奖励。（免申即享）

1. 支持对象。

首次获批集成电路领域省级制造业创新中心、省级产业创新中心、省级技术创新中心的依托单位（牵头单位）。

2. 支持标准。

对上一年度新获批的省级制造业创新中心、省级产业创新中心、省级技术创新中心的依托单位（牵头单位），给予1000万元的一次性奖励。

3. 采信依据。

以四川省经济和信息化厅（<https://jxt.sc.gov.cn/>）、四川省发展和改革委员会（<https://fgw.sc.gov.cn/>）、四川省科学技术厅（<https://kjt.sc.gov.cn/>）发布的名单或相关文件为依据（如机构调整，以新机构发布的名单为准）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向二：对国家级创新平台及其参与建设的公共服务平台，为提升服务能力持续投入的，按照平台设备及软件购置费用的30%给予最高1000万元补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

为提升服务能力持续投入的国家级创新平台及其参与建设的公共服务平台。

2. 支持标准。

按照上一年度平台设备及软件购置费用的 30% 给予每年最高 1000 万元补贴。

3. 附加材料。

(1) 国家级创新平台认定文件以及其参与投资建设的公共平台证明文件；

(2) 购买设备或软件汇总表，采购合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件；

(3) 购买设备或软件的交付证明材料（包括但不限于：实地照片、收发货单/凭证等）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向三：对牵头承担国家集成电路领域重大项目、重大技术攻关计划和重点研发计划的，根据项目国拨资金到位进度，按照 1:0.5 比例给予单个项目总额最高 2000 万元的配套资金支持。（免申即享）

1. 支持对象。

2023 年 1 月 1 日以后获得立项，牵头承担集成电路领域国家发展改革委或工业和信息化部重大专项项目、国家重大技术攻关计划和重点研发计划项目的企业，不含特殊类涉密项目。

2. 支持标准。

按照企业实际获得国家专项支持资金的 50% 给予配套资金支持，单个项目总额最高不超过 2000 万元。资金拨付至申报国家项目四方监管账户，与上级资金同步管理使用。

3. 采信依据。

以国家发展改革委、工业和信息化部相关文件，以及国拨资金到位文件为依据（如机构调整，以新机构发布的名单为准）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

第十一条 强化产业金融支持作用。

支持方向一：对企业因特定业务使用供应链金融服务的，按照实际支付手续费的 50% 给予每年最高 100 万元补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

因开展特定业务，使用供应链金融服务产生手续费的企业。

2. 支持标准。

按照实际支付手续费的 50%，给予每年最高 100 万元补贴。

3. 附加材料。

(1)企业提供有关特定业务需求的证明材料(自行脱密,必要时查验原件);

(2)企业提供供应链金融服务合同、支付手续费发票及银行划款凭证等相关材料复印件;

(3)企业提供供应链金融服务合同资金流向合规的证明材料,包括资金使用说明、购买材料、部件凭证及相关银行转账记录等。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

支持方向二:对企业因特定业务发生承兑汇票贴现的,按照实际支付利息费用的50%给予每年最高100万元的贴息补贴。(易申快享)

1. 申报条件。

(1)因特定业务获得汇票,在银行等金融机构办理承兑汇票票据贴现业务的企业;

(2)贴现票据(指银行承兑汇票和商业承兑汇票)上一手背书人为非关联企业。

2. 支持标准。

对企业按照实际支付利息费用的50%,给予每年最高100万元的贴息补贴。

3. 附加材料。

(1)企业提供有关特定业务需求的证明材料(自行脱密,必要时查验原件)

(2)企业提供交易合同或订单、增值税发票等贴现票据相关交易证明资料复印件(自行脱密,必要时查验原件);

(3)企业提供贴现票据复印件(需包含票面、背书信息),贴现业务办理凭证(需显示银行印章)复印件;

(4)企业提供贴现资金流向合规的证明材料,包括贴现资金使用说明以及相关银行转账记录等。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

第十二条 加快打造专业化园区。

支持方向一:对整合区域资源,在专业园区内建设打造具有行业显示度的产业展示中心的企业,给予最高1000万元的一次性补贴。(易申快享)

1. 申报条件。

(1)整合区域资源,在成都高新区专业化园区内建设打造具有行业显示度的产业展示中心,助推区域产业影响力提升的企业;

(2)产业展示中心建设运营单位需在项目实施前报成都高新区电子信息产业局,并获得成都高新区管委会同意建设。

2. 支持标准。

按照企业建设打造产业展示中心产生的实际费用，给予最高 1000 万元的补贴。

3. 附加材料。

(1) 产业展示中心情况介绍，需详细说明中心选址、建设目标、建设内容、建设单位、整合产业资源情况、建设投入、运行效益（经济、社会）、现场图片等信息；

(2) 产业展示中心建设、购置（租赁）应用场景产品的相关合同、发票、银行划款凭证及验收证明等相关材料复印件；

(3) 由会计师事务所出具的产业展示中心建设费用专项审计报告（带二维码）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向二：对国家“芯火”双创基地在专业园区内建设公共服务平台的，给予最高 500 万元的一次性补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

在成都高新区专业化园区内建设公共技术服务平台的国家“芯火”双创基地运营单位。

2. 支持标准。

按照国家“芯火”双创基地在专业化园区内建设公共技术

服务平台产生的实际费用，给予最高 500 万元的补贴。

3. 附加材料。

(1) 国家“芯火”双创基地的批复文件；

(2) 公共技术服务平台情况介绍，需详细说明平台选址、建设目标、建设内容、服务企业、建设投入、平台效益（经济、社会）、现场图片等信息；

(3) 公共技术服务平台建设费用相关的合同、发票、银行划款凭证及验收证明等相关材料复印件；

(4) 由会计师事务所出具的公共技术服务平台建设费用专项审计报告（带二维码）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向三：对产业展示中心、公共服务平台的运营单位，经评审，分别给予每年最高 300 万元的专项运营补贴。

（易申快享）

1. 申报条件。

符合支持方向一、二申报条件且实际开展运营的产业展示中心/公共服务平台的运营单位。

2. 支持标准。

按照产业展示中心/公共技术服务平台运营单位的实际运营费用，给予每年最高 300 万元的专项运营补贴。

3. 附加材料。

(1) 产业展示中心/公共技术服务平台实际运营成本费用相关的合同、发票及银行划款凭证等材料复印件；

(2) 由会计师事务所出具的产业展示中心/公共技术服务平台运营费专项审计报告（带二维码）；

(3) 产业展示中心提供年度运营报告，包括运营情况、对外展示情况、达成效益（经济、社会）等；公共技术服务平台提供年度对外服务清单，包括服务单位、服务设备、服务机时、服务费用、企业评价等。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

第十三条 支持资质认证及市场应用。

支持方向一：对首次通过 IATF16949、ISO26262 等体系认证的企业，给予 50 万元/个的一次性奖励。对首次通过 ISO26262 产品功能安全或 AEC-Q 车规级标准认证的芯片产品，给予 10 万元/个的一次性奖励。对材料、零部件、装备企业产品首次通过 SEMI 标准认证的，给予 20 万元/个的一次性奖励。单个企业每年最高奖励 200 万元。（易申快享）

1. 申报条件。

(1) 上一年度内通过 IATF16949、ISO26262 等体系认证的集成电路企业；

(2) 上一年度内自研芯片产品通过 ISO26262 或 AEC-Q 认证的集成电路设计企业；

(3) 上一年度内企业自研材料、零部件、装备通过 SEMI 标准认证的集成电路材料、零部件、装备企业；

(4) 第(1)(2)(3)条满足其一即可。

2. 支持标准。

(1) 对上一年度取得 IATF16949 汽车质量管理体系认证、ISO26262 产品功能安全认证的企业,给予 50 万元一次性奖励；

(2) 对首次通过 ISO26262 或 AEC-Q 认证的芯片产品,给予单个产品 10 万元的一次性奖励；

(3) 对首次通过 SEMI 标准认证的材料、零部件、装备企业产品,给予单个产品 20 万元的一次性奖励；

(4) 单个产品通过同一体系中多个认证标准的,不重复享受奖励,单个企业每年最高奖励 200 万元。

3. 附加材料。

(1) 通过体系认证的,提供获得相关资质的证明文件及说明,不限于认证证书、认证合同、费用发票等复印件；

(2) 通过产品认证的,提供产品说明、获得相关认证的证明文件,不限于认证证书、具有资质的第三方出具的测试报告、客户应用报告等证明材料。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向二：对终端企业采购非关联行业企业芯片或模组产品，且采购金额在 500 万元以上的，按照采购金额的 10% 给予最高 100 万元补贴（供需双方各 5%），单个企业每年最高补贴 200 万元。（易申快享、免申即享）

1. 申报条件。

（1）采购非关联行业企业自研芯片或含自研芯片的模组产品，且单个企业采购金额在 500 万元以上的终端（模组）企业；

（2）向条件（1）的企业销售自研芯片或含自研芯片的模组产品，且通过成都市集成电路设计企业评估的企业；

（3）第（1）（2）条满足其一即可。

2. 支持标准。

（1）对供需双方均可按上一年度购销合同实际采购金额的 5%，给予最高 50 万元的补贴；单个企业每年最高 200 万元。

（2）政策由需求方统一申请，审核确定支持金额后，采信需求方的材料，对供应方按“免申即享”拨付支持资金。

3. 附加材料。

（1）上一年度采购产品汇总清单，需详细说明实际供应商（通过代理采购的列明代理商）、产品名称（型号）、功能、数量、实际购销费用等信息；

（2）采购合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件；

(3) 供应方的正版软件使用证明材料、反映集成电路设计企业产品自主创新能力的证明材料（集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权等）复印件（供方协助提供）；

(4) 供应方通过成都市集成电路设计企业评估的证明材料（供方协助提供）。

(5) 通过代理商采购的，需提供代理关系及采购产品真实的佐证材料，不限于设计企业与代理商的代理合同，采购芯片型号对应关系，发货清单等材料。

(6) 通过代理采购的，提交供方出具的关于代理关系真实性承诺书。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

第十四条 支持产教融合发展。

支持方向一：对企业主导与国际国内高校、科研院所共建集成电路人才实训基地的，按照企业建设投入费用不超过20%给予最高500万元的一次性补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

(1) 牵头与国际国内高校、科研院所所在成都高新区内共建集成电路人才实训基地的企业；

(2) 企业上一年度主营业务收入超过2000万元（主营业务指集成电路设计、晶圆制造、封装测试、装备材料等业

务)；

(3) 集成电路人才实训基地已建成投入运营。

(4) 以上(1)(2)(3)条需同时满足。

2. 支持标准。

经专家评审，符合集成电路紧缺人才培养方向的人才实训基地，按照企业建设人才实训基地投入费用的20%给予基地最高500万元的一次性补贴。

3. 附加材料。

(1) 人才实训基地情况介绍，说明基地总投资、建设单位、建设内容、企业建设投入、建成效益(经济、社会)等信息；

(2) 与高校、科研院合作共建人才实训基地的合作协议、立项材料等相关材料复印件；

(3) 建设投入相应的合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件；

(4) 由第三方会计师事务所出具的人才实训基地建设投入费用专项审计报告；

(5) 人才实训基地开展人才培养工作的相关材料(包括但不限于：培训记录、实训照片、为企业输送人才证明等)。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向二：对市内高校、科研院所将仪器设备等科学装置开放给集成电路行业企业使用的，按照服务费用的 20% 给予最高 300 万元奖励，鼓励将以上奖励资金部分用于对运营团队的个人奖补。（易申快享）

1. 申报条件。

将仪器设备等科学装置开放给成都高新区内集成电路行业企业使用的成都市内高校、科研院所。

2. 支持标准。

按照企业所付服务费用的 20% 给予单个高校、科研院所每年最高 300 万元奖励。

3. 附加材料。

（1）服务企业情况统计表；

（2）成都市内高校、科研院所和集成电路行业企业之间签订的仪器设备等科学装置的使用协议、收款凭证、银行划款凭证等相关资料复印件；

（3）高校、科研院所提供的仪器设备等科学装置协助企业研发的说明（包括但不限于：科学装置介绍、服务企业名称、服务效果）。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

支持方向三：鼓励集成电路企业及市内高校、科研院所

开展产业生态合作，围绕材料、设备（零部件）、IP、软件等方向联合研发自主可控产品、技术，对通过晶圆制造、封测链主企业验证的，按照项目自投研发费用的 20% 给予最高 500 万元补贴。（易申快享）

1. 申报条件。

围绕材料、设备（零部件）、IP、软件等方向联合研发自主可控产品、技术，且成果通过晶圆制造、封测链主企业验证的集成电路企业、市内高校、科研院所。

2. 支持标准。

按照项目自投研发费用的 20% 给予最高 500 万元补贴。

3. 附加材料。

- （1）与链主企业合作研发协议或项目立项文件复印件；
- （2）申报项目的研发投入专项审计报告（带二维码）
- （3）项目成果通过晶圆制造、封测企业验证的证明材料（加盖合作双方企业公章）；
- （4）其他证明业务真实性的材料。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局企业服务处。

第十五条 支持提升行业影响力。

对服务集成电路产业，推动区域产业竞争力及行业影响力提升的行业组织，给予每年最高 150 万元奖励。（易申快

享)

1. 申报条件。

(1) 申报单位须为成都高新区注册的独立非营利性机构，独立开展相关服务1年以上，服务能力强，能为成都高新区集成电路集群提供产业研究、交流合作、项目导入、产业链升级、投融资、区域品牌、人才培养等专业服务；

(2) 上一年度实际运营费用超过50万元；

(3) 以上(1)(2)条需同时满足。

2. 支持标准。

(1) 按照上一年度对成都高新区关于集成电路建圈强链、资源整合、跨区域行业重大合作、行业领军团队引进及培育、重大国际国内会议举办等工作参与情况、贡献情况、相关机构评价等情况，依据多维度指标权重综合评价，择优评选出最多3个机构，根据评审结果给予每年最高不超过150万元奖励；

(2) 得分在60分(含)及以上、70分以下的，给予40万元奖励；得分在70分(含)及以上、80分以下的，给予80万元奖励；得分在80分(含)及以上、90分以下的，给予120万元奖励；得分在90分(含)及以上的，给予150万元奖励；

(3) 奖励资金不超过机构实际运营费用80%。

3. 附加材料。

（1）上一年机构实际运营费用（不含政府类服务外包费用和全职人员工资）的相关合同、发票和付款凭证；

（2）行业组织建设情况（包括不限于：行业组织简介、成员（单位）名单及简介、章程、专职人员情况及佐证资料等）；

（3）一般业务活动开展情况（包括不限于：围绕集成电路研发、生产、销售等领域，实施专业化课题研究、开展专业培训、人才招聘、行业交流、融资对接、市场拓展等企业服务活动情况以及活动方案、活动现场照片、各级媒体报道、课题报告、成果报告等佐证资料）；

（4）成都高新区重点工作参与情况（包括不限于：参与成都高新区关于集成电路产业建圈强链、资源整合、跨区域行业重大合作、行业领军团队引进及培育、重大国际国内会议举办等工作情况及佐证，如相关工作或活动方案、成果报告、合作协议、各级媒体报道、获得省市区相关单位表扬等资料）；

（5）特色活动开展情况（包括不限于：针对集成电路产业发展重点、难点、痛点，开展特色创新活动，取得良好工作成效情况及佐证，如活动方案、活动现场照片、各级媒体报道、成果报告、被相关部门作为典型案例或作为经验推广宣传等资料）；

（6）服务对象台账（包括区内重点企业或相关机构、联

系人及联系方式)；

(7) 申报资料涉及的各类活动、项目、重点工作不包含区本级政府购买服务项目的承诺函；

(8) 其他需要提供的资料。备注：以上涉及的各类活动、项目、重点工作等，不含区本级政府购买服务项目，此项将进行延伸审计；(3)(4)(5)涉及的项目之间不可重复。

4. 受理部门。

成都高新区电子信息产业局平台创新处。

六、监督管理

(一) 成都高新区电子信息产业局会同财政局组织实施政策兑现资金的监督和管理，对企业政策兑现资金的使用情况进行抽查。

(二) 成都高新区电子信息产业局负责组织开展绩效评价工作。获得本政策扶持资金的单位应积极配合资金绩效评价工作，按要求提供评价资料。

(三) 对弄虚作假套取、骗取财政资金以及不按计划实施、挪用财政资金的单位，经查实，取消其三年内申请享受成都高新区扶持资金的资格，并依法追究其相应责任。

(四) 咨询、审计等中介机构对其编制的审计、评估等报告的客观性、公正性、独立性负责。

七、解释说明

(一) 本实施细则自 2024 年 11 月 8 日起施行，有效期

两年，由成都高新区电子信息产业局负责具体解释，并根据情况适时修改完善。如遇因上级政策调整需对本细则内容进行调整的，以调整通知为准。

（二）本政策与区级其他政策条款相似的，同一企业按照“取高不重复”的原则执行。已享受“一企一策”相关政策的企业不再重复享受本政策类似条款（相同、类似或“一企一策”明确不能享受等）。国家、四川省、成都市另有规定的除外。

（三）专项审计报告、年度财务审计报告需带注册会计师行业统一监管平台防伪二维码等防伪标识。

信息公开属性：主动公开

成都高新区电子信息产业局

2024年10月8日印发
